

Code SH	Désignation	Observations
ex 8466.91	Parties de machines à scier pour le découpage en tranches de lingots monocristallins ou de plaquettes en microplaquettes	Pour l'Appendice B
ex 8466.91	Parties de machines de découpage en dés pour le grattage ou le rainurage des plaquettes à semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8466.91	Parties de machines à meuler, à polir ou à roder pour le traitement des plaquettes à semi-conducteurs	
ex 8466.93	Parties de fraiseuses opérant par faisceaux ioniques focalisés, destinées à la production ou à la réparation de masques et réticules des motifs de dispositifs à semi-conducteurs	
ex 8466.93	Parties de machines à laser pour le découpage par rayon laser des pistes de contact, destinées à la production de semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8466.93	Parties de machines travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, destinées à la production de plaquettes à semi-conducteurs	
ex 8456.93	Parties d'appareils pour le décapage ou le nettoyage des plaquettes à semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8466.93	Parties de machines pour la gravure à sec du tracé sur les matières semi-conductrices	
ex 8477.10	Matériel d'encapsulation pour l'assemblage de semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8477.90	Parties de matériel d'encapsulation	Pour l'Appendice B
ex 8479.50	Machines automatisées pour le transport, la manutention et le stockage de plaquettes à semi-conducteurs, de cassettes de plaquettes, de boîtes de plaquettes et d'autres matériaux destinés à des dispositifs à semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8479.89	Appareils pour la croissance et le tirage de lingots monocristallins de semi-conducteurs	
ex 8479.89	Appareils à dépôt physique par pulvérisation sur les plaquettes à semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8479.89	Appareils pour l'attaque par humidification, le développement, le décapage ou le nettoyage des plaquettes à semi-conducteurs des systèmes d'affichage à écran plat	Pour l'Appendice B
ex 8479.89	Appareils de fixation de puces, appareils de transport automatique sur bande et microsoudes de fils pour l'assemblage de semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8479.89	Matériel d'encapsulation pour l'assemblage de semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8479.89	Machines à dépôt épitaxial destinées à la fabrication de plaquettes à semi-conducteurs	
ex 8479.89	Machines à souder, à plier et à dresser les fils de sortie de semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8479.89	Appareils à dépôt physique pour la production de semi-conducteurs	Pour l'Appendice B